文章编号:1674-2974(2017)04-0118-06

一种新型双频段可变增益低噪声放大器^{*}

陈迪平*,蒋广成,马俊

(湖南大学物理与微电子科学学院,湖南长沙 410082)

摘 要:采用 SMIC 0.13 μ m RF CMOS 工艺,设计了一款新型的双频段可变增益低噪 声放大器(DBVG-LNA),应用于 GSM900/DCS1800 双频网络通讯系统中. 分别采用多谐振 网络和开关谐振网络完成输入输出双频段阻抗匹配,采用共栅旁路管和开关切换电阻完成 4 挡可调增益,有效地解决变频段和变增益兼容难的问题. 另外,采用共源共栅差分对结构 获取高隔离度和低二次谐波失真. 1.2 V 电源电压,版图面积为 0.43 μ m ×0.65 μ m. 仿真 结果表明,在 GSM900 频段电压增益 20.6~12.7 dB 4 挡可调,NF:1.45~2.05 dB;在 DCS1800 频段电压增益 19.3~11.2 dB 4 挡可调,NF:1.36~2.55 dB;S₁₁均小于-17 dB.

关键词:低噪声放大器;双频段;可变增益;阻抗匹配 中图分类号:TN402

New Dual-band Variable Gain Low Noise Amplifier

CHEN Diping[†], JIANG Guangcheng, MA Jun

(School of Physics and Electronics, Hunan University, Changsha 410082, China)

Abstract: This paper proposed a dual-band variable gain low noise amplifier (DBVG-LNA) by using SMIC 0.13 μ m RF CMOS process. The DBVG-LNA can be used in GSM900/DCS1800 dual-band wireless networking communication system. The multi-resonance network and switching resonant network are used respectively to achieve the input and output dual-band impedance matching. The common gate bypass transistor and switching resistance are used to obtain four variable gains, effectively solving the problem where the variable band and variable gain are incompatible. In addition, a cascode differential topology was used to get a high isolation and a low second harmonic distortion. With a supply power of 1.2 V, the layout area of the circuit is 0.43 μ m×0.65 μ m. The simulation results show that when the voltage gain range is 20. 6~12.7 dB, NF is 1.45~2.05 dB in GSM900 band, while when the voltage gain range is 19.3~11.2 dB, NF is 1.36~2.55 dB in DCS1800 band. Moreover, both S₁₁ are below -17 dB.

Key words: low noise amplifier; dual-band; variable gain; impedance matching

随着移动互联时代的到来,无线通讯产品支持 多种通信标准成为迫切需求^[1],兼容多频段的射频 前端成为了目前热门的研究对象.除此之外,为了扩展系统动态范围,要求射频前端增益可配置.低噪声

文献标志码:A

* 收稿日期:2016-09-17
 基金项目:湖南省科技计划项目(2014FJ1003), The Planned Science and Technology Project of Hunan Province(2014FJ1003)
 作者简介:陈迪平(1962-),男,湖南醴陵人,湖南大学教授
 †通讯联系人,E-mail;chdp@hnu.edu.cn

放大器常作为接收链路的第一级,其增益、线性度及 噪声系数等指标直接影响接收前端的整体性能.近 年来,在多标准接收机设计中,完成一款频带和增益 同时可配置的低噪声放大器显得尤为重要.

有很多种实现双频段的方法,文献[2]采用三阶 切比雪夫带通滤波器实现宽带输入阻抗匹配,但引 入宽频段的噪声对后级镜像抑制提出更高要求.文 献[3]采用工作在不同频段的低噪声放大器并联结 构,面积和功耗都因此增加一倍.文献[4]论述了开 关切换电感,调整谐振频率的方法,但阻抗匹配程度 受限于片内电感的Q值^[5].同样也可以通过改变输 入管跨导、输出负载以及增加旁路管或衰减通路等 多种方法改变增益,文献[6]调整偏置电压实现增益 可调,但不支持多频段.文献[4,7]虽然支持多频段, 但不能提供多挡增益且均采用单端输入单端输出结 构,二次谐波抑制较差.文献[1,8]在片内实现单端 转差分,但片内有源巴伦对工艺依赖性强,存在一定 程度的增益和相位误差,并针对不同的调制模式有 不同程度的影响.

本文设计了一款应用于 GSM900/DCS1800 系 统的差分低噪声放大器,输入采用片外无源阻抗匹 配网络^[9-10],输出采用开关电容和抽头电感构成的 并联谐振网络,获得较好的双频段阻抗匹配.低噪放 核心电路采用带源级退化电感的共源共栅差分对, 获得较高的二阶交调截止点.利用共栅旁路管和 MOS开关电阻组合的形式,在几乎不影响输入输出 阻抗匹配的前提下,完成四挡增益可调.结果表明, 在不同频段不同增益的情况下,输入输出阻抗匹配、 噪声性能符合预期要求.

1 LNA 指标分析及设计

全差分低噪声放大器的整体电路如图 1 所示. $D_1 \sim D_4$ 为二极管组成的 ESD 防护电路,为了节省 面积, L_s , L_{OUT} 均采用抽头式电感,电路可分为以下 5 部分.输入阻抗匹配: L_A , L_B , L_C , C_A 构成片外双频 段阻抗匹配网络; C_X , C_{gs} , C_{PAD} , M_1 , L_s 及 ESD 防护 电路构成片内双频段阻抗匹配网络. 跨导级: M_1 , M_2 , M_3 , M_4 及 L_s 构成的共源共栅差分对,抑制共 模信号、衬底电源噪声的同时,减小二阶交调失真. 输出阻抗匹配:输出采用 RLC 并联结构,在相应频 段获得较高增益的同时,滤掉带外干扰信号.增益控 制: M_5 , M_6 构成旁路管, M_7 , M_8 为 MOS 开关电阻, M_9 , M_{10} 为增益可调辅助管,分别由 $S_1 \sim S_3$ 控制.



图 1 双频段增益可变低噪声放大器(DBVG-LNA) Fig. 1 Dual-band variable gain low noise amplifer(DBVG-LNA)

1.1 噪声系数

共源共栅噪声模型如图 2 所示.由于栅感应噪 声模型还未完善^[11],且"1/f"噪声在高频处被噪声 基底淹没,本文分析中只考虑无源器件电阻热噪声、 栅极电阻热噪声及沟道热噪声,分别为:

$$\overline{V_{n},R^{2}} = 4KTR\Delta f \tag{1}$$

$$\overline{V_{\rm n}, R_{\rm g}^2} = \frac{4}{3} KTR_{\rm g} \Delta f \tag{2}$$

$$I_{\rm nd}^2 = 4KT\gamma g_{\rm d0}\Delta f \tag{3}$$

片外无源器件近似等效为图 2 矩形虚线框模型, Z_{in1} 是低噪放单端输入电阻; R_{g1} , R_{g2} 分别为 M_1 , M_2 的栅极寄生电阻; L'_g 为片外匹配网络等效电感;

C_L为负载电容.源级退化电感可提供一个没有噪声 贡献的实阻抗,C_x的引入提供一个新的自由度,方 便其他元件值的选取,但是该等效输入管的截止频 率下降,进而引起增益下降.忽略沟道调制效应,输 入阻抗推导如下:

$$\text{Re} (Z_{\text{inl}}) = \frac{g_{\text{ml}}L_{\text{S}}}{C_{\text{gsl}} + C_{\text{X}}} + R_{\text{Ls}} + R_{\text{gl}} + R_{\text{Lg}'} \quad (4)$$

Im
$$(Z_{inl}) = s(L_s + L_g') + \frac{1 + g_{ml}R_{Ls}}{s(C_{gsl} + C_X)}$$
 (5)



图 2 共源共栅结构噪声模型 Fig. 2 The noise model of cascode circuit

从式(4)可知,电感的寄生电阻对实阻抗有一定 贡献,而退化电感寄生电阻的存在让谐振点往高频 偏移.本设计采用1:1的巴伦,理想情况下,两路差 分输入阻抗虚部为0且实部为25Ω,输入界面无反 射,功率传输最大.输入回路可以等效为 RLC 串联 谐振,忽略寄生电阻可得输入回路Q值: $Q_{in} \approx$ $1/2\omega R_s(C_{gs} + C_x);输入谐振频率: ω ≈ 1/$ $<math>\sqrt{(L_s + L_g')(C_x + C_{gs1})};$ 共源输出阻抗: $Z_{out1} \approx$ $(2r_{on1} + sL_s)//1/sC_D;$

 $L_{
m s} \ll L_{
m g}', C_{
m D} < C_{
m X}, \omega^2 L_{
m s} C_{
m D} \ll 1$,则 M_2 等效跨导:

$$G_{\rm m_2} \approx \frac{-g_{\rm m2} r_{\rm on2}}{r_{\rm on2} + (1 + g_{\rm m2} r_{\rm on2}) Z_{\rm out1}} \approx$$

$$\frac{-g_{m2} \cdot (2r_{on1}C_{\rm D}s - \omega^2 L_{\rm S}C_{\rm D} + 1)}{1 + 2g_{m2}r_{on1} - \omega^2 L_{\rm S}C_{\rm D} + (g_{m2}L_{\rm S} + 2r_{on1}C_{\rm D})s}$$
(6)

低频时等效跨导约为 $-g_{m2}/(1+2g_{m2}r_{on1})$,随 着频率上升, g_{m2} 增加,共栅管对噪声的贡献增加.

根据图 2 给出的噪声模型,可推导 LNA 工作 在 DCS1800 频段且增益挡位最大时噪声因子表 达式:

$$F \approx 1 + \frac{R_{g1} + R_{Lg'} + R_{Ls}}{R_{S}} + g_{m1}R_{S}\gamma(\frac{\omega_{o}}{\omega_{T}})^{2} + 4R_{S}(\frac{\gamma}{g_{m2}} + R_{g2})(\frac{g_{m2}\omega_{o}}{\omega_{T}})^{2} + \frac{4R_{S}Z_{out2}}{R_{L}}(\frac{\omega_{o}}{\omega_{T}})^{2}$$
(7)

其中 ω₀ 为谐振频率, R_{Lg} 为片外匹配网络等效 寄生电阻, R_{Ls} 为源级电感寄生电阻. R_{L,total} 为等效

输出负载约为
$$R_{ ext{ iny L}}$$
 // $rac{\omega^2 L_{ ext{ ext{ out}}}^2}{R_{ ext{ ext{ out}}}}$

从式(7)可知,为减小噪声因子,需提高晶体管 截止频率,减小输入匹配电路和栅极寄生电阻.为减 小高频时共栅管噪声贡献,需减小共源管漏极寄生 电容 C_D.本设计中,M₁,M₃采用最小沟道长度晶体 管,保证输入匹配的前提下,尽量减小 C_x电容,以此 增加 ω_T.片外采用高Q值电感,输入管采用多指结 构版图,进一步减小噪声系数.以上分析针对 LNA 工作于 DCS1800 频段且最大增益情况下,当切换增 益和切换频带时,增加的 MOS 管会进一步恶化噪 声性能.

1.2 双频段

图 1 中,当 BS 为 0 电平时, M_{11} , M_{12} 关闭, C_1 , R_1 , L_{out} 谐振在 DCS1800 频段;反之, M_{11} , M_{12} 开启, $C_1 \parallel C_2$, R_1 , L_{out} 谐振于 GSM900 频段. LNA 输入匹 配电路及阻抗随频率变化曲线如图 3 所示,其中右 边虚线代表 M 模块的阻抗,实线代表 AB 两端输入 阻抗.由式(5)可知,为了消除输入阻抗中的虚部,在 高频段需要一个较小的电感,在低频段需要一个较 大的电感.本文选易实现的双频段输入匹配方案:首 先预设 C_A , L_c 初始值,使两者在 ω_2 串联谐振;然后 先并联一个电感 L_B ,再串联一电感 L_A ,接入电路使 得输入阻抗匹配网络在 ω_2 处谐振;然后调整 L_B 的 值,使 M 模块在 ω_1 提供一个感抗,使得输入阻抗匹 配网络在 ω_1 , ω_2 处同时处于谐振状态;最后重复以 上步骤,对其电容电感进行微调,使得输入匹配电路 在 GSM900 及 DCS1800 均处于较优谐振.



图 4(a)为 LNA 输出匹配电路,同等驱动能力下,选用 NMOS 型开关管较 PMOS 贡献更小的寄 生电容. 当工作于 GSM900 频段,开关管开启时,导 通电阻 r_{on11} 与 C_2 串联,等效并联电阻为 $R_P = 1/(\omega \cdot C_2)^2 r_{on11}$,该电阻与 R_L 并联,设考虑导通电阻 时的增益为 A_V ,忽略导通电阻时的增益为 A_V' ,推导如下:

$$A_{\rm V} = G_{\rm m} R_{\rm L} = G_{\rm m} \pi f_{\rm Low} Q_{\rm LOUT} L_{\rm OUT}$$

$$A_{\rm V}^{'} = G_{\rm m} \left\{ \left(\pi f_{\rm Low} Q_{\rm LOUT} L_{\rm OUT} \right) // \left(\frac{f_{\rm Low}^2 C_2^2 r_{\rm onl1}}{4} \right) \right\}$$

$$(9)$$

假定开关管导通电阻为 1 Ω, C_2 = 18 pH, Q(L_{OUT}) = 15, f_{Low} = 915 MHz,相对不考虑导通电 阻时,增益约下降 7.28 dB.为了减小增益的衰减, 应选用宽长比大的开关管,以此减小导通电阻.当工 作于 DCS1800 频段,开关管关闭,假定 $C_p \approx 0.1 \times$ C₁,则由于 C_p 的存在,输出匹配网络谐振点往低频 方向偏移 10%.为了减小该项分量引起输出谐振点 的偏移,首先在设计电路初应预留可容忍的偏移裕 度,其次应选用较小尺寸的开关管.折中考虑大尺寸 开关管将引起高频段谐振点的偏移及小尺寸开关管 将引起增益的衰减,本文首先单独仿真开关管,最终 确定 M_{11} , M_{12} 尺寸为(400/0.13) μ m.

1.3 可变增益

图 4(b)给出增益可调的半边电路, S_1 开启时 M_5 将流过一部分信号电流,当 M_2 和 M_5 尺寸相同时,电压增益约下降一倍.当 S_2 或 S_3 开启时,其导通电阻与 R_L 并联.假定导通电阻等于 R_L ,电压增益下降 6 dB.

 M_5 开启时有: $Z_{in2} \approx 1/g_{m2} + 1/g_{m5} < 1/g_{m2}$, M_1 的栅漏增益减小,密勒电容折合到输入端的电容减小,因此 S_{11} 往高频偏移;因为 M_5 远离输出谐振电路,所以对输出影响较小. M_7 的寄生电容直接影响输出谐振点,并往低频偏移;而 cascade 结构的反向隔离度较好,其对 S_{11} 的影响较小. 综合考虑两者的优缺点,本文采用 M_5 粗调增益 M_7 微调增益结 合的结构,在输入输出阻抗匹配频率偏移允许的范围内,在两个频段下完成4挡可调增益.

*M*₅ 与共栅管 *M*₂ 类似,在导通时,其沟道热噪 声及栅极电阻热噪声对噪声系数有一定贡献.而 *M*₇ 导通时,线性区沟道热噪声也会增加噪声系数.因此 最低增益挡位,噪声性能最差.



图 4 (a)双频段输出网络 (b)增益可调半边电路 Fig. 4 (a)Output network of dual-band (b)Single side circuit of variable gain

2 LNA 优化及版图实现

2.1 电路优化

 M_7 开启时的寄生电容对应的阻抗随着频率的 增加而减小,所以在 GSM900 频段, M_7 开关引起的 增益差小于 DCS1800 频段.如图 1 所示,为了使得 双频段对应的相邻挡位增益差相差不大,引入增益 辅助管 M_9 , M_{10} .高频段不开启,低频段工作状态和 M_7 一致,即 $S_3 = \overline{BS} + S_2$.

噪声优化分为电路结构优化和版图优化.首先 在功率约束下进行噪声优化,来选定输入管的宽度. 其次,由公式(5)可知,噪声主要由输入管栅感应噪 声(第2项)和输入管沟道热噪声(第3项)构成.本 设计将低噪放有源部分生成S参数,加入ADS中 进行阻抗匹配设计,使用调谐软件进一步优化噪声 性能.单芯片中射频端口采用射频二极管做ESD防 护,二极管和焊盘大概贡献300 fF的寄生电容.除 此之外,频段切换开关、增益切换开关也会引入一定 的寄生电容,所以输入输出谐振点都会因此而产生 频率偏移.在设计之初,负载电容减小相应的值,并 留有一定的裕度,以保证输入输出谐振点在一定的 范围.本设计中输出端采用2.4 nH的抽头电感,高 频段 C₁=2.8 pF,低频段 C₁=17.9 pF 的电容.

2.2 芯片实现

图 5 给出 DBVG-LNA 芯片整体版图,版图面 积为 0.43 μm×0.65 μm. 版图分为 LNA_core、数 字控制、LDO、Bias 以及 ESD 5 部分.



图 5 芯片版图 Fig.5 The layout of chip

整体版图采用中心对称结构,器件之间采用局 部匹配,保证较好的谐波抑制的同时,减小输出与输 入的反向传输,避免系统振荡.采用紧凑布局设计开 关管,减小寄生电容.加宽走线,减小开关管导通电 阻,进而避免增益的损失.采用高层金属走射频信号 线,减小射频信号与衬底间的耦合,采用带有隔离环 的射频 MOS 管,并在 LNA_core 电路周围加入保 护环,以此隔离模块与衬底及模块与模块之间的干 扰,提高噪声性能.

3 LNA 仿真结果及分析

本设计采用带封装参数的 TDK 电感电容完成 阻抗匹配,在 ADS 中仿真并导出 S 参数,最终在 Cadence 中联合仿真验证,结果如图 6 所示.





当 BS 为高电平时,DBVG-LNA 工作在 GSM900频段,当"S1S2S3"分别为"011","000", "111","100"时,电压增益分别为 20.6 dB,17.8 dB,15.1 dB,12.7 dB;NF分别为1.45 dB,1.49 dB,1.95 dB,2.05 dB; S_{11} 分别为-18.8 dB,-20.3 dB,-25.2 dB,-24.4 dB.当 BS为低电平时,DB-VG-LNA 工作在 DCS1800 频段,当" $S_1S_2S_3$ "分别 为"011","000","111", "100"时,电压增益分别为 19.3 dB,16.5 dB,13.5 dB,11.2 dB;NF分别为 1.36 dB,1.44 dB,2.4 dB,2.55 dB; S_{11} 分别为 -17 dB,-18 dB,-22.5 dB,-22.8 dB.因为 DB-VG-LNA 后接 MIXER, S_{22} 不是关键指标,但单独 测试 DBVG-LNA 时,需要匹配到 50 Ω,该芯片测试 电路, S_{22} 均小于-15 dB.现有变频段变增益低噪声

Chinese)

放大器与本设计性能参数比较如表 1 所示.相对文 献[2]采用的宽带结构,本文提出的低噪放输入匹 配、噪声性能及功耗均占优;文献[4]采用窄带结构, 不支持多挡增益.文献[12]提出的低噪放增益可调 且支持两个频段,输入匹配较好.但噪声性能较差, 功耗约为本文的 2 倍,版图面积约为本文的 5 倍.

参数	文献[2]	文献[4]	文献[12]	本文
工艺/µm	0.18	0.18	0.18	0.13
频率/GHz	0.9~2.25	$2.3 \sim 2.5$ $5.1 \sim 5.3$	2.4 5.25	$0.93 \sim 0.96$ $1.80 \sim 1.83$
电压增益 ¹ /dB 功率增益 ² /dB	$12^2 \sim 29^2$	15^{2} 15^{2}	$\begin{array}{c} 16.\ 6^1 \sim \! 19.\ 9^1 \\ 16.\ 2^1 \sim \! 2.\ 63^1 \end{array}$	$\begin{array}{c} 12.\ 7^{1} \sim 20.\ 6^{1} \\ 11.\ 2^{1} \sim 19.\ 3^{1} \end{array}$
NF/dB	1.5~5.5	2.3 2.4	2.856 3.094	$1.45 \sim 2.05$ $1.36 \sim 2.55$
S_{11}/dB	<-11	<-13 < -15	-25.5 -22.7	<-18.5 <-17
面积 /(mm×mm)	_	0.9×0.9	1.25×1.26	0.43×0.65
功耗/mW	17.19	9 5.04	16.78	8.7

表 1 低噪声放大器性能的比较 Tab. 1 Comparison of proposed LNA performance

4 结 论

本文在对现有多频段可变增益低噪声放大器的 分析与总结的基础上,针对变增益与变频段兼容问 题,提出了一款新型双频段增益可调低噪声放大器. 通过增加旁路管和可变负载调节增益,通过片外多 谐振网络和切换负载电容完成输入输出双频段匹 配.该低噪放在 GSM900 频段电压增 20.6~ 12.7 dB 4 挡可调,噪声系 1.45~2.05 dB,输入反 射系数小于-18 dB;在 DCS1800 频段电压增 19.3 ~11.2 dB 4 挡可调,噪声系数 1.36~2.55 dB,输 入反射系数小于-17 dB,版图面积仅为 0.43 µm× 0.65 µm.结果表明,该低噪声放大器能够满足多标 准可配置接收机要求.

参考文献

 KYOOHYUN Lim, SUNKI Min, SANGHOON Lee, et al. A 2x2 mimo tri-band dual-mode direct-conversion cmos transceiver for worldwide wimax/wlan applications[J]. Journal of Solid-State Circuits: IEEE Solid-State Circuits Society, 2011, 46 (7):1648-1658.

- [2] LI Songting, LI Jiancheng, WANG Jinzhen, et al. Design of 900 ~2 250 MHz broad-band differential LNA with variable gain [C]// 2010 International Conference on Computer Application and System Modeling (ICCASM 2010). Taiyuan, 2010: 581-587.
- [3] ZHANG Pengfei, DER L, GUO Dawei, et al. A single-chip dual-band directconversion IEEE 802. 11a/b/g WLAN transceiver in 0. 18 μm CMOS[J]. Journal of Solid-State Circuits: IEEE Solid-State Circuits Society, 2005,40(9):1932-1939.
- [4] YOO S S, YOO H J. A compact reconfigurable LNA for single path multistandard receiver [C]// Electron Devices and Solid-State Circuits, IEEE Conference on. Tainan, 2007;461-464.
- [5] 曾健平,戴志伟,杨浩,等. 一种具有 0.5dB 噪声系数的 450~470MHz 单片集成 LNA[J]. 湖南大学学报:自然科学版,2014,41(2):91-94.
 ZENG Jianping, DAI Zhiwei, YANG Hao, *et al*. A monolithic 450~470 MHz LNA of 0.5dB noise figure[J]. Journal of Hunan University: Natural Sciences, 2014,41(2):91-94. (In
- [6] ALAM S K, DEGROAT J. A 2 GHz variable gain low noise amplifier in 0. 18-/spl mu/m CMOS [C]// 48th Midwest Symposium on Circuits and Systems, 2005. Covington, KY, 2005: 623-626.
- [7] WU Changching, YEN Albert, CHENG Yu, et al. A switched gain low noise amplifier for ultrawideband wireless applications [C]// 2007 IEEE Radio and Wireless Symposium. Long Beach, CA, 2007; 193-196.
- [8] AZEVEDO F, FORTES F J. Caldinhas Vaz and M. J. Rosario. A dual-band 1. 7V CMOS variable gain low noise amplifier [C]// Design & Technology of Integrated Systems in NanoscaleEra, International Conference on. Rabat, 2007:204 -207.
- [9] SILVA F G S, LIMA R N de, NASCIMENTO S M, et al. A design methodology for concurrent impedance matching networks based on multiresonant circuits [C]// New Circuits and Systems Conference, 2011 IEEE 9th International. Bordeaux, 2011:386-389.
- SILVA F G S, LIMA R N de, FREIRE R C S. A 433/915
 MHz class AB discrete power amplifier based on multiresonant circuits[C]// Integrated Circuits and Systems Design, 2013 26th Symposium on. Curitiba, 2013:1-6.
- [11] DER ZIEL A V. Thermal noise in field effect transistors[J]. Journal of Solid-State Circuits, 1962,50(8):1808-1812.
- [12] SUNG G M, ZHANG X J. A 2. 4 GHz/5. 25 GHz CMOS variable gain low noise amplifier using gate voltage adjustment
 [C]// 2013 IEEE 5-6th International Midwest Symposium on Circuits and Systems. Columbus, OH, 2013;776-779.